

# 信越ポリマー株式会社 2024 年 3 月期 決算説明会

## 社長挨拶要旨

社長の出戸でございます。

本日はご多忙中のところ、弊社の決算説明会にご出席賜りまして、誠に有難うございます。皆様には日頃大変お世話になっており、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

さて、当期は、半導体市場の調整局面が続き、ウエハー容器の販売は緩やかに減少しました。しかしながら、OA 機器用部品は複合機用ローラの受注増、自動車用入力デバイスは日系自動車メーカーの生産回復により受注が増加、機能性材料は自動車電装化の進展を受け、それぞれ堅調に推移しました。加えて、人流の回復によりラッピングフィルムの売上げが増加しました。

この結果、当期における業績は、

・売上高	<u>1,043 億 79 百万円</u>	(前年同期比 38 億 99 百万円の減少)
・営業利益	<u>110 億 50 百万円</u>	(前年同期比 16 億 99 百万円の減少)
・経常利益	<u>115 億 30 百万円</u>	(前年同期比 14 億 56 百万円の減少)
・親会社株主に帰属する当期純利益	<u>86 億 74 百万円</u>	(前年同期比 1 億 45 百万円の増加)

期末配当は 1 株当たり 2 円増配し 24 円とし、年間 46 円とさせていただきます。

今後につきましては、引き続き中期経営計画に沿って基盤領域における販売力強化、生産性向上、成長領域における新規需要の取り込みに努めます。

半導体市場は、一昨年秋以降の調整局面が当該期でも続きましたが、その一方で底打ちの兆しが表れ、長く続いた調整局面の好転が見込まれます。当社は予てより需要増に対応すべく、生産体制の増強を図ってまいりましたが、年内には東京工場でも半導体容器の新棟が完成し、更なる事業の拡大発展を目指します。自動車用入力デバイス・OA 機器用ロール・ラッピングフィルムは今期も前期同様に堅調に推移する見込みです。

今後成長領域として期待できる EV 関連の新規製品（バッテリー用クッション材・SiC 対応の耐熱薄膜フィルム等）の取り込みを積極的に進め中期計画の達成を目指してまいります。

なお、今期の業績予想につきましては、ウクライナや中東地域での情勢不安の長期化など地政学リスクや、各国の金融引き締め、人件費や物流費の増加などの影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況にあり、現時点で算定が困難であることから未定とさせていただき、今後、業績予想の算定が可能となった時点で、速やかに開示いたします。

以上、ご報告とご挨拶とさせていただきます。

# 信越ポリマー株式会社 2024年3月期 決算説明会

## 質疑応答要旨

日時	2024年5月9日（木）14:00～14:45		
開催形式	ウェビナー（ライブ配信）		
登壇者	・代表取締役会長	会長執行役員	小野 義昭
	・代表取締役社長	社長執行役員	出戸 利明
	・取締役 常務執行役員	開発本部長	菅野 悟
	・執行役員	営業本部長	小林 直樹
	・執行役員	経営企画部 経理部 部長	小和田 収
	・執行役員	営業第三部 部長	山本 和彦

### ＜電子デバイス事業＞

- Q1.** 自動車関連製品に関して、電子デバイス事業の営業利益は2023年3月期と比べ2024年3月期3Q以降高水準で推移したが、この先も増収増益で推移する見通しなのか。また、住環境・生活資材事業の自動車関連製品の見通しを教えてください。
- A1.** 電子デバイス事業の製品としては入力デバイスの車載用キースイッチが中心で昨年より需要が回復しており、大きな伸びは期待していないが、出荷数量は前期以上で安定した出荷となると見込んでいる。入力デバイスは海外販売比率が高いため2024年3月期の増収増益は円安の影響もあったが、当面は前期と同様の為替水準が見込まれるため、前期以上の業績を見込んでいる。また、住環境・生活資材事業の導電性ポリマーは自動車用ハイブリッドアルミ電解コンデンサー向けの出荷が非常に伸びており、更なる増収増益を期待している。加えて、自動車の中でも今後伸びると言われるEV向け製品としてキースイッチ以外の新規用途向け製品も開発している。これらの新規製品は、今期は大きな収益への貢献はできないが、来期以降の販売拡大が期待できる。
- Q2.** タッチスイッチも伸びたようだが、車載製品のトレンドに変化があったのか。
- A2.** 入力デバイスの車載向け製品の構成としてキースイッチが8割以上を占めており、現在はタッチスイッチの比率は低い。新たな車種ではタッチスイッチの採用が増えており、車載用途の入力デバイスとしては今後も伸びると見ている。
- Q3.** キースイッチ、タッチスイッチのどちらが増えても収益に変化は無いと考えて良いのか。
- A3.** 大きな影響は無いと見ている。
- Q4.** 欧州ではEV販売が減速しているが、導電性ポリマーの販売に影響するのか。
- A4.** 欧州自動車メーカーの生産が伸びておらず、その影響を受けてはいるが、日系自動車メーカーの生産が伸びており、全体では導電性ポリマーの需要は伸びている。

## ＜精密成形品事業＞

- Q1.** 半導体容器について前期 3Q から 4Q にかけて減収減益だったが、足元で回復の兆しが見えているとご説明いただいた。FOSB と FOUP でそれぞれどのような回復の兆しが見えているのかを教えてください。
- A1.** FOSB はお客様によっては昨年の秋口、遅くとも年明けから大規模な生産調整を行ってきており、徐々にだが、ウエハーの生産調整が終息しつつある。各社で時間差はあるが実需ベースの生産に移行してきており、増産の準備を進めていると認識している。FOUP は今回の需要減速の前に各デバイスメーカーが設備投資を進めていて、その状態のまま設備投資を凍結していたが、生成 AI 用途と言われる高品質ロジック半導体や、それに付随するメモリに関してはすでに前広に投資が再開されており、そのようなお客様からいただくフォーキャストは非常に強くなってきている。
- Q2.** FOSB は前期 4Q から今期 1Q では回復感が見えず、一方 FOUP は多少底を打ち、前期 4Q で回復し、今期 1Q でさらに勢いがついてくるイメージだが、その理解でよいか教えてください。
- A2.** 概ねその通りである。タイミングの問題もあるが、FOUP が先行して回復し、遅れて FOSB が回復するイメージである。
- Q3.** FOSB のリユース率に対する考え方をお伺いしたい。新品ウエハーがデバイスメーカーで過剰在庫となっているが、在庫消化が進み回復局面を迎えるとリユース率がどんどん上がっていくのか、それとも先端半導体向けではリユース率が上がらず、新品ボックスの需要が増えるのか。
- A3.** ウエハーケースの回復が遅れる理由として二つの要素がある。一つはデバイスメーカーとウエハーメーカーの増産は連動しているのだが、現在はデバイスの生産が回復途上であることと、もう一つはリユースボックスの動向による場合がある。リユースに関してはデバイスメーカーとウエハーメーカー間のやりとりであり、当社はその状況を把握しきれていないが、リユース率が上昇する状況も勘案して FOSB の回復が遅れるという見かたをしている。
- Q4.** インテル社が主導する半導体後工程自動化・標準化技術研究組合に御社も参画されているが、参画に至った経緯、御社に求められている役割、将来の収益にどの程度貢献するのかを教えてください。
- A4.** この研究組合の中で当社はワークを自動搬送するためのトレイとキャリアを担当している。インテル社が日本国内で対応可能なメーカーを調査した結果、当社に声がかかったと認識している。最終的に 2028 年の実用化を目指しているが、具体的にどのようなゴールを目指すのかという点は参画している企業間で議論している最中である。先端デバイスに関して後工程への技術要求は非常に高くなってきていると認識しており、4 年後の事業規模については期待をしているが、具体的な金額水準は組合の活動を通して検討していくことになる。
- Q5.** 今回開発する技術はインテル社専用の技術であり、インテル社以外の他社には販売できないという理解でよいか。
- A5.** 基本的にこの組合で開発した技術は標準化が前提となっている。基本的に開発技術は組合に参画する企業のものであり、また、標準化することで幅広く使えるものにしていくことが目的である。
- Q6.** 標準化が目的とすると将来的に大きな事業機会を見込めるのか。
- A6.** 大きな事業機会を見込める可能性はあるが、全ての半導体メーカーが後工程でこの技術を採用する訳ではないという捉え方もあり、成果物についてターゲットをどこに置くかということも組合の議論の中で見出していくことになる。

**Q7.** 精密成形品事業のシリコンゴム成形品事業について今期の需要見通しとその要因を教えてください。

**A7.** シリコンゴム成形品は医療製品が主体であり堅調に推移している。現在進めている新規プロジェクトが来期より本格的に立ち上がる見込みである。医療事業は現時点では大きな事業ではないが、今後伸ばしていく成長事業と捉えている。

以上